

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2026-014

无锡市太极实业股份有限公司
关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **担保对象及基本情况**

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
太极半导体（苏州）有限公司	70,000 万元	22,769.33 万元	不适用：本次为 2026 年度担保额度预计	否

注：“实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）”系截至 2026 年 3 月 31 日无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）为子公司太极半导体（苏州）有限公司（以下简称“太极半导体”）实际提供的担保余额（其中外币担保余额已根据 2026 年 3 月 31 日汇率折算为人民币）。

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	75,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	8.69
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	-

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足业务发展需要，公司 2026 年度拟为子公司太极半导体银行授信提供不超过 7 亿元人民币的担保。其中，为太极半导体向银行申请新增授信提供不超过 20,850 万元人民币的担保，为太极半导体向银行申请授信续期提供不超过 49,150 万元人民币的担保（含授信期限内的担保续期）。

（二）内部决策程序

1、原有担保额度履行的相关决策程序

公司第十届董事会第七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为太极半导体向银行申请新增授信提供不超过 1.99 亿元人民币的担保、向银行申请授信续期提供 2.60 亿元人民币的担保，有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司第十届董事会第十八次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为太极半导体向银行申请新增授信提供不超过 10,843 万元人民币的担保、向银行申请授信续期提供 39,157 万元人民币的担保，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司第十届董事会第二十五次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为太极半导体向银行申请新增授信提供不超过 15,100 万元人民币的担保、向银行申请授信续期提供不超过 44,900 万元人民币的担保（含授信期限内的担保续期），有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述担保额度预计后，公司为太极半导体提供担保总额度为 7 亿元。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2023-016、临 2024-023、临 2025-013）。

2、本次担保预计事项履行的相关决策程序

公司已于2026年4月24日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意了本次担保预计的事宜。本次担保预计事项尚需提交公司股东会审议批准。董事会提请股东会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项并签署各项法律文件。

本次担保额度预计后，公司合计为太极半导体提供担保的总额度为7亿元。

（三）担保预计基本情况（如有）

担保方	被担保方	担保 保持 比例	被 担 保 方 最 近 一 期 产 率	保 近 资 债 最 期 负	截至2026 年3月31 日担保余 额	本 次 新 增 担 保 额 度	担保额度 占上市公 司最近一 期经审计 归母净资 产比例	担保 预计 有效 期	是否 关联 担保	是否 有反 担保
一、对控股子公司										
被担保方资产负债率未超过70%										
太极实 业	太极半导 体	100%	54.53%		22,769.33 万元	70,000 万元	8.11%	1年	否	否

注：本次预计的担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	太极半导体（苏州）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股85.06% 公司全资子公司太极微电子（苏州）有限公司持股14.94%
法定代表人	孙鸿伟
统一社会信用代码	913205940601875249
成立时间	2013年1月9日
注册地	苏州工业园区综合保税区启明路158号建屋1号厂房
注册资本	72,210.8475万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围	<p>研究、开发、封装、测试生产半导体产品，并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>一般项目：电子元器件制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；电子元器件批发；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日 /2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日 /2025年度（经审计）
	资产总额	111,960.13	108,078.60
	负债总额	61,057.33	57,668.42
	资产净额	50,902.80	50,410.19
	营业收入	21,415.96	74,955.91
	净利润	498.67	-2,166.12

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计额度，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计事项，系基于公司子公司太极半导体的业务发展需要，有利于提高融资决策效率，满足其生产经营资金需求，保障其业务的正常开展，符合公司整体利益。

被担保方太极半导体为公司全资子公司，公司能够全面了解并及时掌握其经营情况及财务状况。太极半导体资信状况良好、具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第十一届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》并提交公司股东会审议。前述议案尚需公司股东会审议批准。

董事会认为：公司本次担保系根据子公司太极半导体业务经营的实际需要而进行，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范担保行为，公司本次进行的担保决策程序合法，同意本次担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 75,000 万元，均为公司对控股子公司的担保，占公司 2025 年经审计归母净资产的 8.69%。公司及子公司不存在为公司控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期担保情况。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日